












LAGENAUFBAU HDI (Standard)														
HDI10_2+6+2_1,20_35			10 - Lagen							Kerne: 0,15 mm Cu 35/35 µm				
WE-Artikel Nr.:		2 + 6 + 2								KUNDE:				
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG					
KUNDE	WE							[µm]	[µm]					
1	TOP/VS				Folie	12 µm	1) ¹⁾	12						
2	VSK1				Folie	12 µm	1 x 1080	60						
3	2					35 µm		33						
4	3				0,150 mm			150						
5	4					35 µm		33						
6	5					35 µm	2 x 1080	124						
7	6				0,150 mm			150						
8	7					35 µm		33						
9	RSK1				Folie	12 µm	1 x 1080	60						
10	BOT/RS				Folie	12 µm	1) ¹⁾	12						
					1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm									
					Gesamtdicke Material: 1220									
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)									
MATERIALDICKE:		1,20	+/-	0,10	mm	Datum:		Bearbeiter:						
DICKE über galv. Endoberfläche		1,29	+/-	0,13	mm									
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,35	+/-	0,15	mm									
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:								
Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision								
27.03.2006	S. Keller	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00		Seite: 8+						